

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	长江证券、贝莱德、Willing Capital、万向创投、利幄私募、明河投资、理成资产、益和源资产、睿郡资产、途灵资产、黑翼资产、上银基金、东兴基金、东北证券、东方阿尔法基金、中信保诚基金、中信股衍、中信资管、人保资产、中国人保健康、中金公司、中泰证券、中邮证券、中金资管、中金基金、九泰基金、信达澳亚基金、信达资本、光大保德信基金、光大永明资产、光大证券、全天候私募、兴银理财、创金合信基金、前海开源基金、宏道投资、瞰渡资产、禹田资本、华夏财富创新、华安基金、华富基金、华能贵诚信托、华龙证券、合众资产、嘉实基金、固禾资产、国信证券、国元证券、国泰基金、国泰海通、国联基金、国联安基金、天弘基金、天风证券、安和资本、安捷证券、宏利基金、宝盈基金、富国基金、富安达基金、工银理财、平安基金、由榕投资、建信人寿、招商基金、招银理财、摩根士丹利基金、新华基金、旭松投资、易方达基金、景顺长城基金、格林基金、江苏瑞华投资、浙商证券、深圳固禾私募、前海红筹资本、红筹投资、玄卜投资、申万宏源、申万菱信基金、红土创新基金、统一投信、英大保险资管、蓝海启程、财通证券资管、银河证券、长信基金、长城证券、长城财富资管、阳光资产、青榕资产、青骊投资、鹏华基金
时间	2026年3月24日
地点	公司上海办公室 及 线上会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、关于2025年年度业绩的说明</b></p> <p>首先简要回顾财务数据：营业收入，4.38亿元，同比增长45%。归母净利1.02亿元，同比增长148%；归母扣非净利1亿元，同比增长162%。</p> <p>利润的增长幅度大幅超过收入增长，反映了公司较强的业绩弹性。主要原因有三：首先，公司是具备“从硅材料到硅零部件”一体化完整生产能力的国产厂商，确保了公司硅零部件业务的增长和毛利，两个业务互相促进，公司硅零部件</p>

业务已经成为第二曲线，收入体量超越了大直径硅材料；第二，公司硅材料业务的开工率提升，不管是公司硅零部件业务的新增消耗，还是直接对外出售硅材料的增加，都提高规模效益，降低边际成本；第三，公司经营稳健、高效，销售费用、管理费用、财务费用相对较低。

## 二、硅零部件业务的增长预期

目前公司已取得了中国本土硅零部件市场的领先地位，已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链，以高端品类为主，发挥了独特的国产化作用。公司正在根据下游需求持续扩产，力争沿着过去数年的发展曲线，确保产能增长和生产良率的最佳平衡。

## 三、中国存储芯片产能增长对公司的影响

管理层认为，纵观过去五十余年的全球半导体产业历史，存储芯片作为大宗品，其产能的重心转移，向来是全球芯片制造产能转移的先声——从美国到日本的转移，以日本东芝公司的崛起为标志；从日本到韩国及中国台湾的转移，以韩国三星公司的崛起为标志。正在发生的第三次转移，很可能以中国存储芯片制造厂商的崛起为标志。

2025年第三季度以来，国际领先的存储厂商相继宣布退出消费级存储芯片业务，让出了广阔的全球消费级存储芯片的市场空间，为中国本土存储芯片制造厂商提供了难得的机遇。后者有望发挥中国在消费电子终端、智能网联汽车、具身智能机器人等领域的庞大潜力，赢得未来全球市场。此外，中国本土人工智能产业对高端存储芯片产能的渴求，也是中国本土存储芯片的长期发展动力。

综上，有志于成为世界级公司的中国厂商，必须抓住这次产业转移所带来的机会。

公司的大直径硅材料产品及其制成品硅零部件，是高端存储芯片制造所需等离子刻蚀环节中的核心耗材，开工率越高、刻蚀强度和次数越多，消耗量越大。根据公司自主调研数据，2026年，中国大陆硅零部件市场规模有望达到约70亿元人民币。公司将稳扎稳打，力争抓住未来几年中国存储芯片产能大规模建设、国产化率提升的机遇。进一步强化公司第二增长曲线即硅零部件业务，作为“材料+

零部件”公司植根中国本土市场，发挥“自产材料+零部件”的综合实力，带动公司自产大直径硅材料的用量，发挥公司业绩“成长性”之潜力。

#### 四、公司对潜在地缘政治事件的影响评估

公司没有日资背景，乃是一家由中资团队创立的中国本土企业，致力于中国集成电路制造核心工艺材料和零部件的国产化建设。目前公司大部分收入来自中国本土市场，已在供应链国产化方面取得长足进展。

当前，中国本土半导体材料和零部件产业仍处于起步阶段，地缘政治事件对供应链的潜在影响既是挑战更是机遇。公司将密切关注事态发展，提前筹划供应链寻源和国产化工作，加强库存管理，争取在未来的国产化浪潮中取得佳绩。

#### 五、公司对2026年半导体市场的展望

2024年以来，全球半导体市场有所回暖，但结构性特征却极为显著，且其背后驱动力与以往周期大相径庭：终端需求的来源，并非消费者对智能手机、个人电脑等电子产品的日常消费，而是科技巨头企业为提供人工智能服务而竞相投入的资本开支，在产业历史上尚属首次。

因此，半导体各细分市场的景气度高度分化：与消费电子相关的成熟市场仍处于萧条期，而与人工智能相关的新兴高端市场却供不应求，景气度高涨。

公司管理层综合市场研究数据认为：2026年海外科技巨头在人工智能领域的资本开支将超过单季度1,000亿美元，将为本次周期结构性回暖提供强劲动能，建设庞大的芯片制造产能。因此，本次周期回暖的市场规模峰值有望超过上一周期（2021-2022年）。

另一方面，芯片制造产能及其配套的基础设施建设，乃是极为复杂的系统工程，难以一蹴而就，因此海外下游市场需求的释放节奏可望长于上一周期。

中国国内市场方面，由于海外厂商退出消费级存储芯片市场的短期刺激，叠加本土人工智能领域长期需求，中国本土存储芯片制造产能有望继续增长；此外，随着海外先进逻辑芯片代工厂削减成熟制程产能，国内逻辑芯片代工厂将获得新的发展动能，以填补其供应缺口，将刺激中国本土逻辑芯片制造产能增长。

值得注意的是，当前中国本土芯片设计和制造所需要的工业软件、材料、零

	<p>部件及关键设备的国产化进程已经进入“深水区”，仍然任重而道远。此外，今年以来，地缘政治军事冲突频发，干扰能源矿产和基础工业品的生产、运输，可能造成上游材料及产成品的涨价乃至供应紧缺，也可能造成下游客户生产延迟乃至停止，为全行业带来宏观环境风险。</p> <p>公司业务同时受益于海外和中国市场需求。公司将紧密跟踪市场变化，积极应对、审慎决策，为股东创造长期价值。</p>
附件清单	无
日期	2026年3月26日